

平成28年12月期

第2四半期決算説明資料



株式会社 石井工作研究所
ISHII TOOL & ENGINEERING CORP.

<http://www.i-kkco.jp>

決算説明資料の構成

1. 平成 28 年 12 月期第 2 四半期決算概要
2. 平成 28 年 12 月期通期業績予想
3. 会社概要

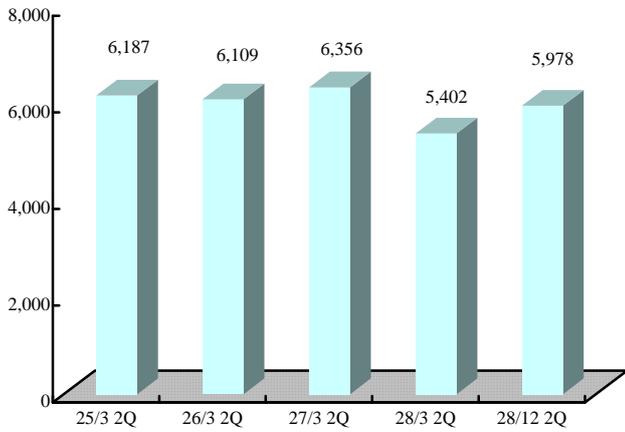


1. 平成28年12月期第2四半期決算概要

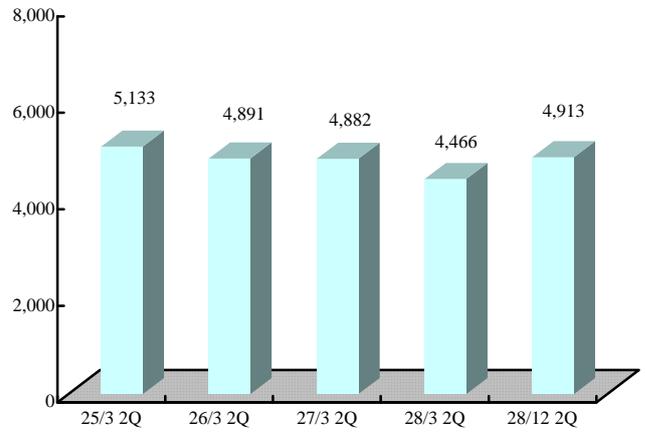


財務状態 Financial Condition

総資産 Total assets (百万円/¥Millions)

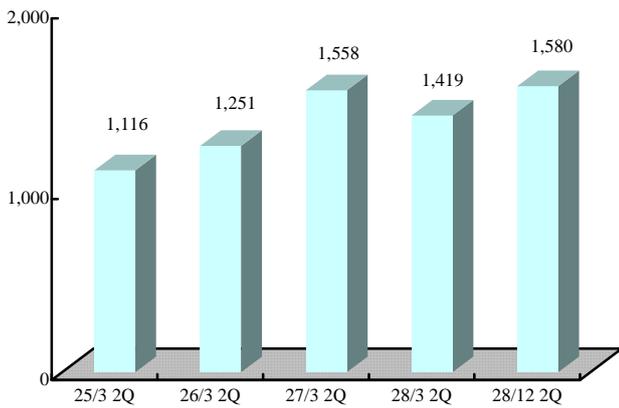


純資産 Shareholders' equity (百万円/¥Millions)

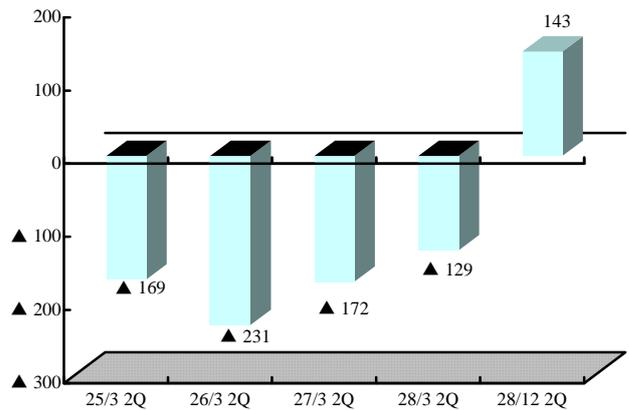


業績推移 Operating results

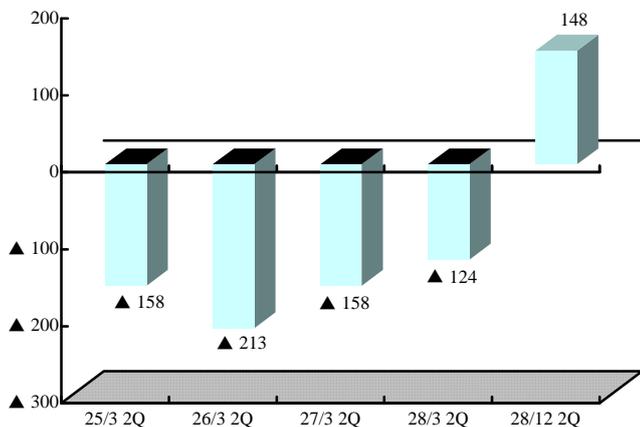
売上高 Net sales (百万円/¥Millions)



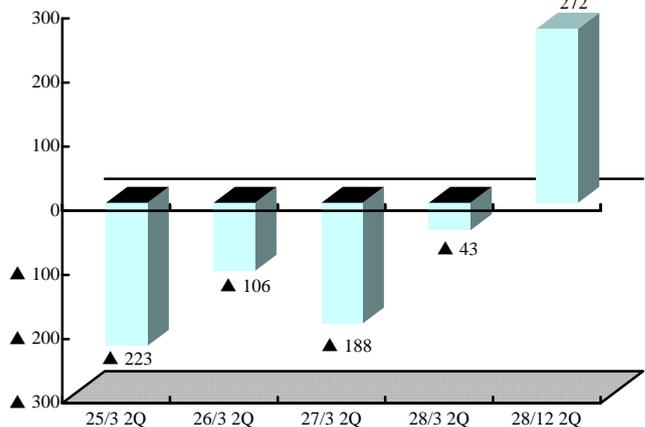
営業利益又は営業損失 Operating income or loss (百万円/¥Millions Millions)



経常利益又は経常損失 Ordinary income or loss (百万円/¥Millions)



四半期純利益又は四半期純損失 Net income or loss (百万円/¥Millions)



セグメント別販売実績

セグメントの名称	販売高(千円)	前年同四半期比(%)
半導体・自動車関連事業	1,579,122	111.6
不動産・建築関連事業	908	21.3
合計	1,580,031	111.3

(注)1. 最近2事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

なお、当該割合が100分の10未満の場合は記載を省略しております。

相手先	前第2四半期累計期間		当第2四半期累計期間	
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)
第一実業(株)	552,254	38.9	848,508	53.7
ジェイデバイス(株)	—	—	274,956	17.4
三菱電機(株)	161,384	11.4	—	—

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

セグメント別受注状況

セグメントの名称	受注高(千円)	前年同四半期比(%)	受注残高(千円)	前年同四半期比(%)
半導体・自動車関連事業	1,819,433	156.1	1,453,707	169.6
不動産・建築関連事業	443	10.7	169	41.4
合計	1,819,877	155.6	1,453,876	169.5

(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。



2. 平成28年12月期業績予想

第39期(平成28年12月期)の利益計画

(注)第39期は決算期の変更(3月31日を12月31日)に伴い、平成28年4月1日から平成28年12月31日までの9ヶ月の変則決算となります。したがって、対前年増減は記載しておりません。

a. 利益計画表

(単位:千円)

項目	期別		第39期予想		増減
	第38期 (28年3月期)		第39期予想 (28年12月期)		
	千円	%	千円	%	千円
売上高	2,863,710	100.0	2,600,000	100.0	—
売上原価	2,397,576	83.7	1,973,551	75.9	—
売上総利益	466,133	16.3	626,449	24.1	—
販売管理費及び一般管理費	402,860	14.1	426,449	16.4	—
営業利益	63,273	2.2	200,000	7.7	—
営業外収益	21,143	0.7	17,700	0.7	—
営業外費用	10,256	0.4	7,700	0.3	—
経常利益	74,160	2.6	210,000	8.1	—
特別利益	116,029	4.1	180,000	6.9	—
特別損失	331	0.0	—	0.0	—
税引前当期純利益	189,857	6.6	390,000	15.0	—
法人税及び住民税	5,566	0.2	62,621	2.4	—
法人税等調整額	30,822	1.2	7,379	0.3	—
当期純利益	153,469	5.2	320,000	12.3	—

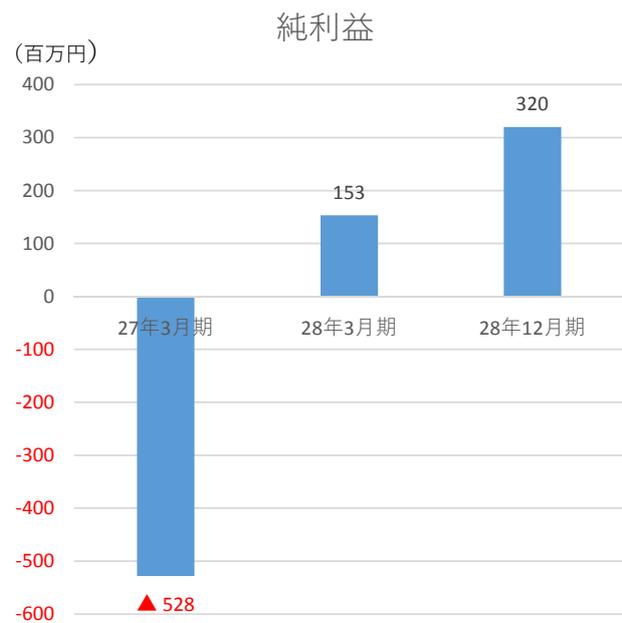
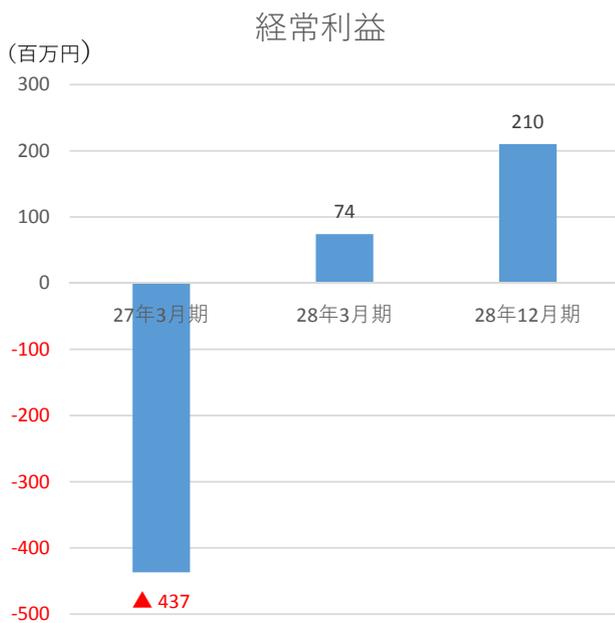
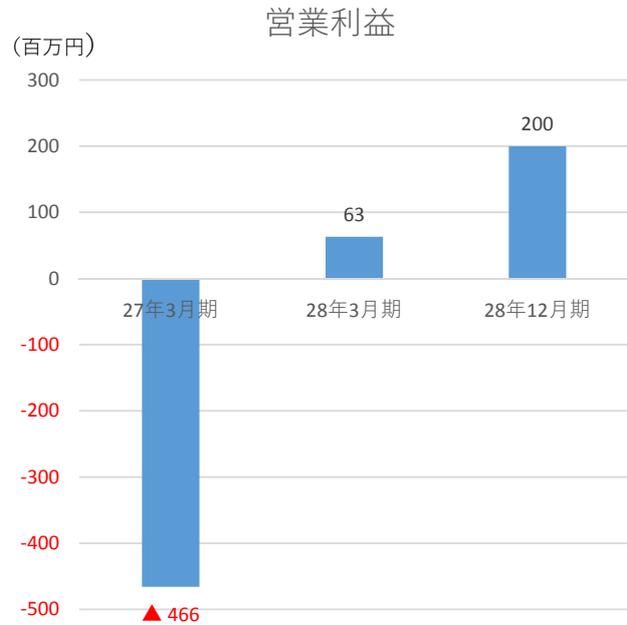
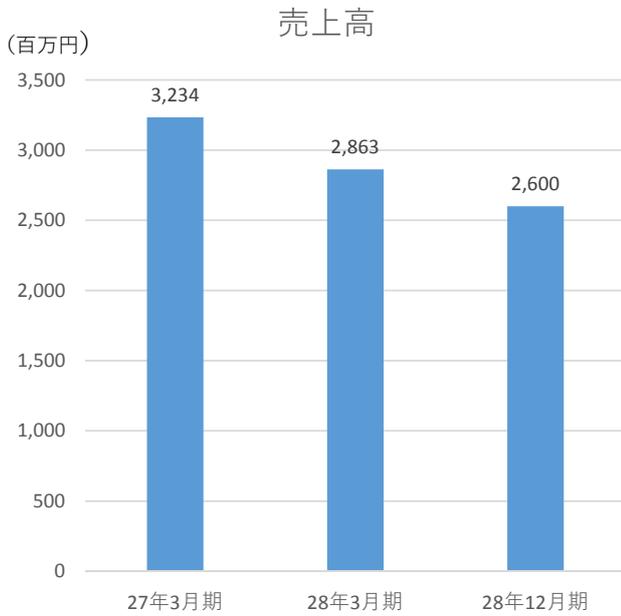
b. 販売高のセグメント別内訳

(単位:千円)

セグメントの名称	期別		第39期予想		増減
	第38期 (28年3月期)		第39期予想 (28年12月期)		
	千円	%	千円	%	千円
半導体・自動車関連事業	2,848,180	99.5	2,598,000	99.9	—
不動産・建築関連事業	15,529	0.5	2,000	0.1	—
合計	2,863,710	100.0	2,600,000	100.0	—

※本資料に掲載されている業績予想、見通し、事業戦略につきましては、現在入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により予想と異なる結果となる可能性があります。

平成28年12月期の目標





3. 会社概要

会社の概要

(平成 28 年 9 月 30 日現在)

商 号 株式会社 石井工作研究所
(英訳名 ISHII TOOL & ENGINEERING CORPORATION.)

本 店 大分県大分市東大道二丁目 5 番 60 号

設立年月日 昭和 54 年 (1979 年) 1 月 5 日

事業内容

セグメント の名称	区 分	主 要 営 業 品 目
半 導 体・ 自 動 車 関 連 事 業	半 導 体・ 自 動 車 関 連 製 造 装 置 及 び 金 型	半 導 体・自 動 車 関 連 製 造 装 置 各 種 精 密 金 型
	加 工 部 品	プ ラ ス チ ャ ッ ク 成 型 加 工 品 プ レ ス 加 工 品、金 属 加 工 部 品
	電 装 品	マ イ ク ロ コ ン ピ ュ ー ター、電 装 装 置
	そ の 他	購 入 品、補 修 サ ー ビ ス
不 動 産・建 築 関 連 事 業	マ ン シ ョ ン 及 び 住 宅	個 人 住 宅・住 宅 用 ホ ー ム エ レ ベ ー タ 太 陽 光 発 電 装 置

資 本 金 1,186,300,000 円

株式の状況 会社が発行する株式の総数 30,000,000株

発行済株式総数 7,800,000株

1単元の株式数 100株

決 算 期 12月31日 (年 1 回)

代 表 取 締 役 社 長	佐 藤 一 彦
専 務 取 締 役	中 野 雅 一
取 締 役	重 松 秀 信
取 締 役	時 枝 典 生
取 締 役	中 村 昭 彦
取 締 役	(非常勤) 村 井 雄 司
取 締 役	(非常勤) 尾 石 上 人
取 締 役	(非常勤) 岐 部 和 久
取 締 役・監 査 等 委 員	(常 勤) 衛 藤 良 一
取 締 役・監 査 等 委 員	(非常勤) 伊 東 徳
取 締 役・監 査 等 委 員	(非常勤) 靱 倉 了 胤

従 業 員 数 232名 (従業員には、臨時従業員 (準社員) を含んでおりません。)

主要取引銀行 株式会社 大 分 銀 行 本 店

株式会社 三 井 住 友 銀 行 大 分 支 店

三井住友信託銀行株式会社 大 分 支 店

大 株 主

株 主 名	当 社 へ の 出 資 状 況	
	持 株 数	持 株 比 率
モバイルクリエイト株式会社	3,181 千株	40.93 %
石井工作研究所 従業員持株会	869	11.18
石 井 光 明	150	1.93
石 井 仁 海	139	1.79
日本証券金融株式会社	89	1.14
渡 邊 俊 雄	87	1.12
株式会社SBI証券	77	0.99
松井証券株式会社	77	0.99
楽天証券株式会社	61	0.79
石 井 貞 憲	60	0.78

(注) 持株比率は、自己株式(28,086株)を控除して計算しております。

会社の沿革

年 月	概 要
昭和 54 年 1 月	(株)石井工作研究所設立(資本金 10,000 千円)。前身である個人企業石井工作研究所より人員その他すべてを引継ぎ、精密金型、半導体関連製造装置の開発、設計、製造、販売を主業務とした事業を開始。本社及び本社工場(旧大分工場)を大分県大分市東大道二丁目1番3号に置く。
昭和 54 年 6 月	金属及び非金属材料販売を行うため丸善通商(株)設立。
昭和 55 年 10 月	数値制御による機械加工を集約するため(株)大分エヌシーセンター設立。
昭和 56 年 4 月	熊本及び福岡での販売を強化するため熊本県熊本市に熊本営業所開設。
昭和 56 年 5 月	当社及び関連会社の不動産管理のため大分県大分市に(有)石井工研産業設立(後、株式会社へ組織変更)。
昭和 58 年 12 月	丸善通商(株)を(株)九栄システム(現北九州工場)に商号変更するとともに本社を北九州市門司区に移転。
昭和 59 年 1 月	業容の拡大と合成樹脂製品製造、販売のため、大分県テクノポリス地域の指定を受けた大分県杵築市に杵築工場開設。
昭和 60 年 2 月	関西及び関東以北での販売を強化するため、大阪事務所を大阪市北区に東京事務所を東京都新宿区に開設。
昭和 61 年 3 月	半導体組立工程の5工程(①リードフレームからの切り離し ②足の折り曲げ ③性能テスト ④製品名などの印刷 ⑤分類)を一貫処理できる半導体自動組立装置「PTMD300」を(財)大分県高度技術開発研究所をはじめ、大分工業高等専門学校や大分大学と共同開発。
昭和 61 年 8 月	半導体製造用の低騒音、超小型のNCモータープレスの「ソフトプレス」を開発。
昭和 61 年 11 月	日本国内での販売を強化し、新製品販売促進のため東京晴海での半導体製造装置展示会“セミコン・ジャパン 86”に初めて出展。
平成 3 年 10 月	経営の合理化と経営効率を図るため、(株)大分エヌシーセンター、(株)九栄システム及び(株)石井工研産業を吸収合併。
平成 4 年 3 月	当社の「ソフトプレス」を使った半導体製造の後工程一貫製造装置が、「第4回中小企業優秀新技術・新製品賞」(協和(現りそな)中小企業振興財団・日刊工業新聞共催)を受賞。
平成 4 年 9 月	「IC検査用画像処理装置」を開発。
平成 5 年 7 月	アメリカでの世界最大の半導体製造装置展示会“セミコン・ウエスト 93”に初めて出展。
平成 5 年 9 月	本社ビル完成。
平成 7 年 4 月	大阪事務所及び東京事務所を各々営業所に名称変更。
平成 8 年 8 月	当社株式を日本証券業協会の店頭売買有価証券として登録。
平成 9 年 2 月	ISO9001 認証取得及びCEマーキングライセンス権取得。
平成 12 年 8 月	ISO14001 認証取得。
平成 13 年 6 月	北九州工場を北九州市小倉北区に土地・建物を取得して移転。
平成 13 年 8 月	不動産事業を開始。
平成 14 年 1 月	浄水事業を開始。
平成 15 年 11 月	大分曲工場第一期工事完成。
平成 16 年 12 月	日本証券業協会への店頭登録を取消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。
平成 17 年 12 月	大分曲工場第二期工事完成。
平成 18 年 2 月	大分工場、大分羽田工場の大分曲工場移転完了。
平成 18 年 7 月	本社所在地を大分県大分市東大道二丁目5番 60 号に住所表示変更。
平成 21 年 4 月	北九州工場及び大阪営業所を閉鎖。
平成 21 年 6 月	東京営業所を東京都港区の新築自社店舗に移転。
平成 22 年 4 月	ジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所 JASDAQ に上場。
平成 25 年 4 月	閉鎖していた北九州工場を売却。
平成 25 年 7 月	東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード) に上場。
平成 26 年 5 月	当社創業者石井見敏氏逝去。
平成 27 年 1 月	モバイルクリエイイト株式会社が当社の筆頭株主及び持分法適用会社となる。
平成 27 年 5 月	大分羽田工場を売却。
平成 27 年 10 月	熊本営業所を閉鎖。東京営業所を移転。
平成 28 年 3 月	モバイルクリエイイト株式会社による当社への友好的 T O B が実施され、同社の子会社となる。
平成 28 年 6 月	東京都港区の東京営業所(自社店舗)を売却。
平成 28 年 8 月	閉鎖していた熊本営業所を売却。



営業所及び工場

- ① 本 社 大分県大分市東大道二丁目5番60号
- ② 営 業 所
 東京営業所 東京都港区
- ③ 工 場
 大分曲工場 大分県大分市
 杵築工場 大分県杵築市

本資料に関するお問い合わせ



株式会社 石井工作研究所
ISHII TOOL & ENGINEERING CORP.

IR担当者 時枝

TEL :097-544-1001

E-mail : tokieda@i-kk.co.jp